

证券代码：688403

转债代码：118049

证券简称：汇成股份

转债简称：汇成转债

合肥新汇成微电子股份有限公司

投资者关系活动记录表

(2025 年 8 月 27 日)

编号：2025-002

投资者关系 活动类别	☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☒电话会议 ☐其他（请文字说明其他活动内容）
---------------	--

人员姓名	财务总监：闫柳
投资者关系活动主要内容介绍	1、今年上半年公司业绩实现增长，主要原因有哪些？ 答：今年上半年，受益于下游景气度特别是大尺寸面板和 AMOLED 需求向好、可转债募投项目新扩产能释放、公司产品结构优化策略效果显现等多重因素叠加催化，公司接单量持续增长，高阶产品订单持续导入，对经营业绩提升形成较为显著的促进作用。公司上半年营业收入同比增长 28.58%，达 8.66 亿元，且 2025 年第二季度单季营收规模创历史新高；利润方面提升幅度更为显著，报告期内公司归母净利润实现同比 60.94% 的增长，达 9,603.98 万元。 2、公司 AMOLED 营收占比和毛利率情况怎么样？ 答：自公司可转债募投项目实施以来，公司高阶产品产能配置及产品结构优化策略效果逐步显现，同时受益于 AMOLED 产品渗透率提升及境内产业链产能增长，AMOLED 产品封测业务占比提升较为明显。2024 年度公司 AMOLED 产品收入占比不足 20%，2025 年上半年收入占比已提升至 25% 以上。 AMOLED 产品封测毛利率显著高于 DDI、TDDI 等其他类别，亦高于公司平均毛利率水平。 3、今年上半年公司电子价签 IC 封测业务情况怎么样？ 答：电子价签（即 ESL）产品营收占比在 2025 年上半年提升显著，营收占比已经超过 10%。相较于其他类型封测产品而言，ESL 产品虽然营收占比相对较低，但毛利率表现较为理想，亦对公司盈利能力提升有所贡献。 4、车载显示芯片项目目前进展怎么样？ 答：车载显示芯片项目尚处于厂房工程建设阶段，预计 2026 年年初厂房完工后开始陆续安排设备进线，2026 年内计划完成第一阶段产能配置目标，2027 年将结合客户和市场情况在 2026 年基础上进一步扩产。2025 年内公司将用现有厂房和产线进行客户验证及初步产品导入，预计不会对本年度营收及业绩形成

	较大贡献。 5、公司是否存在新业务规划？进展情况如何？ 答:尚处于规划阶段，公司将积极推进新业务进展。
是否涉及应披露重大信息的说明	不涉及
附件清单（如有）	无
上传日期	2025 年 8 月 28 日